

2013年1月吉日

お客様各位

レイテック株式会社  
営業部**《半導体パッケージング技術展》出展のご案内**

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび当社では、広く皆様に製品のご案内を申し上げるべく

『半導体パッケージング技術展』に、出展する運びとなりました。

つきましては招待状を同封いたしましたので、会場にお越しの際は是非当ブースへお越しくださいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

## 記

- 展示会名 : 半導体パッケージング技術展  
開催日 : 2013年1月16日(水)～18日(木)  
開催時間 : 10:00～18:00(18日[金]のみ17:00まで)  
開催場所 : 東京ビッグサイト 東展示棟  
ブース No. : 東1ホール 東25-002(東レエンジニアリング(株)ブース内)  
展示内容 : ポリイミドエッチング技術(微細穴・多孔・薄膜化)、  
微細FPC基板のご案内  
プローブカードのご案内(エルフィノート・テクノロジー(株))

## お問合せ先

レイテック株式会社 営業部

〒350-1151 埼玉県川越市今福473-2

TEL : 049-246-0202(代表) / FAX : 049-246-0206

URL : <http://raytech-inc.co.jp/>